

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

债券代码：127051

债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-003

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称 及人员姓名	博杰股份 2022 年度业绩说明会，面向全体投资者
时间	2023 年 5 月 19 日 15:00-17:00
地点	深圳证券交易所“互动易平台”（ <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ）“云访谈”栏目
上市公司 接待人员	董事长、总经理 王兆春，副总经理 刘晓勇，财务总监 张彩虹， 独立董事 黄宝山，保荐代表 王虎，董事会秘书 黄璨，证券事务代表 张王均
投资者关系 活动主要内容介绍	<p>1、问：公司在 AR/VR 等可穿戴设备方面有哪些进展？</p> <p>答：公司就 AR/VR 相关视觉检测、光学检测设备与国内外几家知名品牌厂商均有接触，另外公司打造了射频、声学、光学等多工位的测试和检测设备的一站式解决方案。目前公司在 AR/VR 上实现的收入情况因涉及具体客户、项目，基于相关保密协议要求，暂不便透露；可穿戴设备未来会有比较明确的市场需求，公司会继续在可穿戴设备相关的测试需求上开拓延展。</p> <p>2、问：能不能介绍一下公司盈利最强的产品有哪些？有没有持续性？</p> <p>答：公司在电测、射频及高端标准设备上有较强盈利能力，其中大数据、云计算产品相关测试设备随着行业快速发展保持持续发展势头。</p> <p>3、问：请问公司在半导体检测领域布局了哪些设备？半导体设备的研发进展到哪个地步了？相比竞争对手，核心竞争力是什么？</p> <p>答：公司半导体布局：</p>

半导体材料：参股苏州焜原、鼎泰晶圆，布局半导体材料制程；  
在半导体检测和测试领域：布局电测领域与晶圆检测的外观检测；  
在半导体制程领域：布局划片机。

主要核心竞争力：设备的稳定性、精确性，以及公司对客户工艺的理解。

**4、问：公司毛利率怎么下滑了？是什么原因？**

答：您好！主要系随着下游行业应用、客户群体的扩大，相应的产品需求存在差异，产品结构的差异导致毛利率有所波动。谢谢！

**5、问：请问下公司独立董事黄总平时是怎么维护中小股东利益的？有没有按时关注公司情况？**

答：尊敬的投资者，您好，本人通过积极参加公司董事会专门委员会、董事会、股东大会，与公司管理层交流了解公司各项动态，持续关注公司生产经营、内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况。另外积极关注并学习证券监管等相关法律法规，关注外部环境和市场变化对公司的影响，继续加强公司治理、股东权益维护方面的履职。

**6、问：请问公司业务中有没有能跟 AI 大模型结合的？**

答：公司有自研的 AI 平台，可以帮助客户导入智能制造设备。公司正基于 AI 平台开拓更多的客户和业务领域，帮助客户解决生产制造过程中的质量检测问题和柔性化生产问题。

**7、问：公司在汽车电子领域的相关布局有哪些？**

答：在新能源汽车领域，公司主要在 PCB 板测试以及像车载摄像头、车载屏等特定的应用场景领域去进行测试和组装上的研发，以及从单一设备向整线自动化设备的延展；公司对准三电系统、自动驾驶、智能座舱三大系统，从中识别出约 20 多种公司现有技术有能力可覆盖的电子零部件，进行技术和产品延伸。公司看好相关设备领域的业务机会，预计有市场需求达百亿级别。

**8、问：公司在 MLCC 领域的核心竞争力是在哪方面？目前该业务的发展处于哪个阶段？**

答：公司在 MLCC 领域核心竞争力：

(1) 产品技术竞争力，研发团队通过的公司研发平台，运用机器人软件算法、运控能力、AOI 视觉检测人工智能等核心技术，不断突破，已经为客户提

供了六面外观机、测包机、测试机行业领先的优质设备。

(2) 对行业客户工艺的理解，在 MLCC 行业，公司已经服务众多客户，通过为行业客户不断解决工艺挑战同时，也构建公司工艺流程知识库，这些能力，对产品迭代升级有直接的促进作用。

(3) 行业产品缺陷模型数据库，公司在行业内首家应用人工智能算法，为行业客户提供智能丰富解决方案的同时，积累了业内最丰富缺陷模型，这些模型可快速部署，为客户提供快速有效的解决方案。

**9、问：请问公司半导体业务是否有意向客户，预计订单情况如何，对未来业绩贡献预期怎样？**

答：公司划片机业务今年在半导体和泛半导体市场同步突破。半导体领域，瞄准晶圆划片做重点市场攻坚，瞄准日月光、上达、长电等国内龙头企业。基于公司与团队收购时业绩对赌，2023-2025 年三年累计营收需达 1.8 亿元。公司持续看好半导体行业未来发展，继续引进日韩专家对设备进行技术升级，进一步提升良率和稳定性、一致性；同时建立公司半导体市场能力，赋能业务突破。

**10、问：请问董事长，这两年来公司不仅是利润下滑，营收也在下滑，费用却不断增长，请问钱花哪里去了？**

答：公司一直在测试检测领域做技术的深耕和布局，未来公司会沿着机器人软件算法、运控能力、AOI 视觉检测人工智能这三个核心技术能力上做深入的研发和布局。在下游服务器、汽车电子、3C 客户持续布局，其中，在服务器领域占据市场绝对优势，服务 Amazon，英伟达、微软等头部客户。在第二增长曲线上，公司在 MLCC 及半导体领域的布局已有初步成效，其中奥德维在 MLCC 领域实现技术的突破，累计实现不错的订单超 4 个亿，高速测试分选机已正式发布，二代叠层机的研发即将完成，打破外国设备对国内市场的垄断，未来公司会继续沿着 MLCC 上下游制程去实现设备的覆盖及能力的提升；在半导体领域已有样机，一是在前道晶圆表面瑕疵检测、平面度检测，二是分选设备，同时也有收购一家半导体划片机企业，今年公司在半导体领域有望实现业绩从 0 到 1 的突破。在业务能力端上去实现能力的迁移，公司主动匹配客户需求及产业政策的布局，在国内外多个地方建立分公司或工厂，实现快速响应客户需求。另外公司会同步梳理和强化集团化管控，聚焦以形成资源最大化，为公司在

	<p>业务和新客户市场上实现增长进行赋能和支持。</p> <p><b>11、问：请问下公司董事长，公司未来几年的战略方向是什么，能否带领公司走的更好？</b></p> <p>答：公司致力于从非标定制产品为主的提供商，转向标准化、高技术高附加值设备供应商。展望未来，公司将力争开发更多的标准化、高技术高附加值设备产品，快速匹配客户自动化产线需求并打造一体化的智能产线。</p> <p>未来，公司将不断提升企业价值，不仅关注“业务、利润”，更要思考“追求持续、稳步、快速发展”。公司将继续巩固基本盘，同时重新审视公司的战略规划、组织能力和执行效率，强化并购、投资与孵化，为公司长远、持续、稳定、快速发展奠定坚实的基础。</p> <p>通过深度梳理公司当前的战略及市场定位及支持公司长期发展的价值链，锚定公司发展的战略基础。通过引进管理咨询机构，协助公司描绘未来的发展蓝图，勾勒清晰的组织画像，明确组织架构和关键职能，识别组织能力短板，补足关键人才，设置清晰的绩效目标和评价体系，勾勒出人才发展的路径，构建支持个人成长、团队发展、及企业持续增长的、具有竞争力的薪酬及激励体系。让优秀人才不断涌现，组织更高效、更具战斗力，以更好地支撑战略落地。</p> <p>同时，以战略目标为牵引加强集团组织能力，提升销售能力、运营能力、研发能力、市场能力，向并购企业输出管理体系与流程，强化整个企业集团化的管理，实现“上下同欲，力出一孔”。</p> <p>公司将更加积极地为技术创新人才和技术团队打造发展、分享的机制和平台，为有意愿、肯实干、能交付、拿结果的人才打开清晰的成长通道，不断引进和吸纳科技人才以及能够带给公司突破性发展的人才。</p>
<p><b>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</b></p>	<p>本次交流活动不涉及应披露重大信息。</p>
<p><b>活动过程中所使用演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作附件）</b></p>	<p>无</p>